



平成 24 年 8 月 8 日

各 位

上場会社名 T O W A 株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 岡田 博和  
コード番号 6315 (東証・大証 1 部)  
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 岸本 昌利  
TEL (075) 692 - 0251

## 住友重機械工業株式会社との特許相互利用に関する合意のお知らせ

当社と住友重機械工業株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：中村 吉伸、以下「住友重機械工業」と言う）は、両社が保有する特許の一部を相互利用可能とすることで合意いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1、合意の内容

当社と住友重機械工業は、当社が保有する半導体樹脂封止装置分野におけるトランスファ成形のモジュール連結特許のほか、関連する特許の一部と、住友重機械工業が保有する装置内の搬送機構に関する特許等とを相互利用可能とし、権利主張を行わないことについて合意いたしました。

#### 2、目的

半導体製造装置の製造および販売を行う両社は、知的財産の相互利用により、台頭する海外競合先に対する技術優位性をさらに高め、日本のモノづくり企業として高い技術力をもってお客様のニーズに応えることで、さらなる市場シェアの拡大を図ってまいります。

以上